

金めっき

Through our surface treatment technology and results,
Create new values.



金めっきは、優れた導電性・耐食性・外観品質を兼ね備えた表面処理技術として、電子部品、精密機器、医療機器、装飾品など多岐にわたる分野で活用されています。製品の高機能化・高信頼性化が進む中、用途に応じた金めっきの選定はますます重要性を増しています。エルグでは2種類の硬質金めっき・金ニッケルめっきに加え、無電解金めっきの試作対応も行っています。製品仕様や使用環境に応じた最適なめっき技術、膜厚・硬度・密着性・外観などの技術要件にも柔軟に対応できる体制を整えており、試作から量産まで幅広くサポート可能です。

エルグの金めっき

めっき種別	金純度 (Au)	合金成分	硬度 (HV)	主な用途	特長
硬質金めっきA	99.7 ~ 99.99%	Co	約160 ~ 210	接点部品 ワイヤーボンディング	柔軟性・導電性 はんだ付け性に優れる
硬質金めっきB	97 ~ 98%	Co	約250 ~ 300	接点部品 スイッチ	耐摩耗性・長期信頼性
金ニッケルめっき	99%	Ni	約280 ~ 350	スライド接点 摩耗部品	高硬度・変色耐性
無電解金めっき	99%以上	お問い合わせ ください	お問い合わせ ください	微細電極 UBM形成	均一性・複雑形状対応・電流不要

下地めっきあり／なし、両方に対応いたします。

●下地あり

用途や母材に応じた下地めっき処理を施すことで、金めっきの密着性・耐食性・外観品質を向上させます。

- 下地銅めっき : 導電性が高く、厚付け金めっきとの相性が良好
- 下地ニッケルめっき : 密着性・平滑性に優れ、電子部品や精密部品に最適
- 下地無電解ニッケルめっき : 複雑形状や非導電性母材にも対応可能
- オリンピックめっき(下地銅+銀) : 特殊用途向けのCu→Ag→Au多層構造。



●下地なし

下地めっきを施さずに金めっきを直に形成することも可能です。微細部品や特殊形状にも対応可能です。

FAQ(よくあるご質問)

- Q. 金めっきの膜厚はどれくらいですか？
A. 通常0.05~2μm、用途に応じて調整可能です
- Q. RoHS対応していますか？
A. 対応済み。鉛・水銀等は含みません

#SNSやってます

Follow
me!



小さな部品の精密めっき

株式会社エルグ

群馬県富岡市宇田250-6
TEL 0274-62-2421
FAX 0274-64-2379

